



(2,000円)

特許庁長官 殿

特許法第85条に於て
の規定による特許出願

昭和48年1月29日

① 日本国特許庁

公開特許公報

① 特開昭 49-102726

② 公開日 昭49.(1974) 9 27

③ 特願昭 48-11724

④ 出願日 昭48.(1973) / . 29

審査請求 有 (全3頁)

庁内整理番号

⑤ 日本分類

6660 48

24(A)A03

6683 37

24(M)D01

1 発明の名称

電圧降下による積層層の形成方法

2 特許請求の範囲に記載された発明

3 発明者

出願人と同じ

4 特許出願人

住所

東京都中央区西馬場1丁目1番地5

氏名

佐々木 隆

5 特許書類の目録

(1) 願書原本

(2) 明細書

(3) 出願審査請求書

(4) 図面

明 細 書

1 発明の名称

電圧降下による積層層の形成方法

2 特許請求の範囲

1. 導電性膜面に高分子またはそれに等価な粒子状の原料を形成した材料を電圧作用によって塗着させた未反応状態の積層層に、あるいはその上に通常の塗着剤を塗布して成る積層層に、所定の被覆体を密着させたのち、前記被覆体を圧着固化させる塗着処理の方法。
2. 導電性膜面に高分子またはそれに等価な、半導体、異性体あるいは強誘電体のことと電子材料原料粒子を形成した材料を電圧作用によって塗着させた未反応状態の積層層に、あるいはその上に通常の塗着剤を塗布して成る積層層に、圧電素子、半導体素子および誘電素子のことと所定の被覆体を密着させ、しかも前記被覆体を圧着固化させる塗着処理の方法。

方法。

発明の詳細な説明

一般に金属同士あるいは極めて小さな粒子間の金属片と他の被覆体物質の界面に接合するには、合成樹脂膜等で作られた通常の塗着剤を被覆体物質に何らかの方法にて塗着塗布し乾燥させて両者の接合をなさしめる。しかし塗着剤そのものの流動性や粘性はよくとも金属等に対する塗着結果は通常きわめて悪く、また安定性に劣る。殊に少量の塗着剤しか使えないような場合には強固な接合性を得ることが困難である。本発明の方法は金属その他の導電性膜面において電圧作用をとらえて高分子等を塗着させる電圧塗着法によって、塗着した樹脂あるいはこれに原料を配合したものが極めて堅固かつ強固に金属膜面に対して接合させることができるので、これを被覆体積層（または中間層）として利用したものである。

すなわち被覆体積層を陽極とし、他の電極の陰極

以上に示した実施例からもわかるように本発明の方法は、極めて広い利用面がある。そして、結合材料の半導体材料、絶縁体、半導体あるいは強誘電体のごとき電子材料としての用途をもつ材料の微粒子を、電解液溶液中に溶解させて電着することにより、その電気的性質を何れに適合層を形成することができる。

例えば上に述べた実施例のほかには、半導体材料の電気的性質と金属材料の機械的強度とを簡単に交換するためのトランジスタあるいは微細かつ小形の磁気回路の形成などにも極めて効果的な手段となり可能性にも高い方法である。

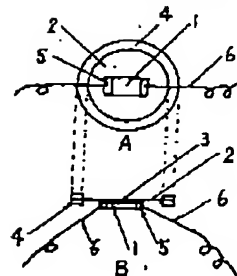
図面の簡単な説明

第1図Aは金属材料表面に半導体薄膜を貼着した上面図であり、第1図Bはその側面図を例示したものである。

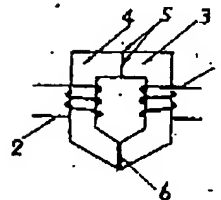
そして第2図は磁気ヘッドの構造を示す断面図である。

特許出願人 松下 電 気 有 限 公 司

特開 昭49-10272E (3)



第1図



第2図